



HTC 无硅导热化合物

产品介绍

Electrolube 导热化合物用于需要高效而可靠地热耦合的电子、电器元件，或用于任何要求导热或散热的表面之间。该产品通常用于电子元件的基材和连接螺栓上，如二极管、晶体管、三极管、散热片、硅可控整流器及半导体、自动调温器、功率电阻器和冷却器等。

HTC 不含硅，因此不会由于在电器接触面上移动而产生高接触阻力、电弧或机械磨损。同样也不会发生由硅化合物引起的低温焊接问题。

无硅产品可用于任何禁止使用含硅化合物的部位或公司对此有正式说明的部位。

Electrolube 还提供多种导热产品，包括用于高温应用的硅膏（HTS）、硅橡胶（TCR）、粘结型环氧体系（TBS）及环氧灌封树脂（ER2074）。

此外还提供导热系数更高的产品，HTSP 及 HTCP，用于热处理要求更苛刻的特殊情形。

特征：

- 优异的防滑动特性。
- 适温范围广。
- 甚至在高温下仍能保持优异的导热系数。
- 易于施工。
- 使用经济。
- 低毒。
- 白色，确保易于确定已处理的部位。
- 低挥发重量损失。

性能：

颜色：	白色
基质：	人工合成混合液
导热组份：	金属氧化物粉末
导热系数：	0.9W/Mk
密度（20℃）：	2.04g/cm ³
温度范围：	-50℃— +170℃
重量损失（168hrs@170℃后）	0.98%
介电常数（10 ⁶ Hz）：	4.2

电阻率: $1 \times 10^{14} \Omega/\text{cm}$
绝缘强度: 42kV/mm
锥入度: 210—250

<u>包装</u>	<u>订货号</u>
2ml 注射器装	HTC02S
10ml 注射器装	HTC10S
20ml 注射器装	HTC20S
35ml 带锁注射器装	HTC35SL
1Kg 装	HTC01K
25Kg 装	HTC25K

北约货号: 6850-99-775-5881 (10ml 注射器装)

5835-99-775-5881 (20ml 注射器装)

版权所有: **Electrolube 2003**

给出的所有信息都是真实的, 但不作担保。所列性能只作指南, 不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能, 为得到最好的性能, 用户亦需尽力提供合适的施工条件。